

半導体供給不足に伴う契約の履行延期等について

1 契約履行延期（解除）申請書の提出について

世界的な半導体供給不足を原因とした履行延期や契約解除又はその懸念等がある場合は、入札及び契約心得に基づき「契約履行延期（解除）申請書」を速やかに契約担当官等に提出してください。

2 契約履行延期（解除）申請書の記載について

契約履行延期（解除）申請書の申請理由欄には、事実に基づき、履行遅延の原因及び理由を具体的かつ詳細に記載するとともに、最大限の注意や予防方法を講じていたことや履行遅延を回避するためにとった措置についても記載してください。欄内に書ききれない場合は、別紙を添付してください。（属紙第1、属紙第2）また、有償及び無償の日数を把握するために、履行遅延につながる事象が発生したことにより、納入がいつからいつに変更になるのか、全般的な工事計画がどのように変わるのかなどを証明する書類についても提出してください。

3 履行延期または契約解除（一部解除を含む。）の有償及び無償の判定並びに事実を証する書類について

(1) 契約の履行に必要な部品等の取得の遅延の原因及び理由が貴社の責めに帰し難い、貴社の努力が及ばないなどの場合であって、かつ貴社においても最大限の努力を払ってもなお、通常より取得（代替可能部品の検討等も含む。）に長期間を要した場合には無償と判定します。

(2) 事実を証する書類について

前号の事実を証する書類は、契約の履行に必要な半導体（部品、構成品等を含む。）の入手困難性に関する文書（根拠の明示）、予見不可能性に関する文書（当初の計画と変更後の計画の明示）、代替入手先又は代替製品の利用の検討状況（国内外の状況）等の文書とします。

具体的には、発注元（供給先）からの部品の在庫不足又は供給遅延を証明する文書、貴社における取得計画の変更に関する文書（他の入手ルート、代替品の検討結果等を含む取得計画の変更がわかるもの）等を指します。